

# 공동평가 계약서

## (Joint Evaluation Agreement)

삼성전자 주식회사(이하 "삼성전자"라 함)와 주식회사 원익아이피에스(이하 "공동평가자"라 함)는 다음과 같이 공동평가 계약(이하 "본 계약"이라 함)을 체결한다.

- 다 음 -

### 제 1 조(공동평가의 원칙)

본 계약에 따른 삼성전자와 공동평가자의 공동평가 작업은 공동평가자가 설비 및 설비의 가동과 관련된 기술, 정보 등을 제공하고 삼성전자는 평가대상 설비의 가동을 위한 환경과 제반 노하우를 제공함으로써 상호 이익을 증대시킬 목적으로 진행되며, 삼성전자와 공동평가자는 비용과 제반 위험의 각자 부담을 원칙으로 하여 성실하게 평가작업을 진행하기로 합의한다.

### 제 2 조(용어의 정의)

- ① "지식재산권"이라 함은 아이디어, 발명, 특허, 실용신안, 디자인, 저작권, 상표권 및 MASK WORK, LAYOUT, Software, KNOW-HOW, 기타 법적 보호를 받을 수 있는 일체의 지적 창작물에 관한 권리를 말한다.
- ② "정보"라 함은 본 계약 이행을 위해 제공된 기술 · 데이터 · 실험자료 · 아이디어 · 사양 · KNOW-HOW 등을 포함하는 일체의 유·무형의 자료와 본 계약을 수행함에 따라 지득하거나 발생된 평가대상 설비의 기능 · 기술 · 데이터 · 실험자료 · 아이디어 · KNOW-HOW · 보고서 등을 포함하는 일체의 유·무형의 자료를 말한다.



### 제 3 조(목표 및 기간)

- ① 삼성전자와 공동평가자는 별첨 1. 평가계획서에 명시된 평가목적, 역할 분담, 일정에 따라 MAHA 설비의 V-NAND 향 MOLD OX 공동평가에 있어 별첨 2. 설비 Spec 의 사양을 만족시키는지 여부를 공동 평가한다.
- ② 본 계약에 따른 공동평가기간은 2015년 11월 9일부터 2016년 11월 8일까지로 하되, 평가기간의 단축 내지 연장이 필요하다고 판단되는 경우 상호 합의하여 그 기간을 변경할 수 있다.

### 제 4 조(평가작업의 진행, 기술지원)

- ① 양 당사자는 본 평가작업을 진행하면서 발생하는 평가 내용 등 “정보”를 공유하며, 일방은 추가 평가나 보완 작업이 필요한 경우 그 사유를 상대방에게 소명하여 추가 평가나 보완 작업의 진행을 요청할 수 있다.
- ② 양 당사자는 평가작업의 원활한 수행을 위하여 본 계약에서 정한 평가목적의 범위에서 최대한의 “정보”를 제공하고 평가 책임자를 각각 선임한다. 평가 책임자는 평가수행 및 발생 문제점을 해결하기 위한 기술회의를 소집할 수 있으며, 기술회의에 대한 일시, 안건 등 세부사항은 양사의 평가 책임자가 협의하여 결정한다.
- ③ 제 1 항, 제 2 항의 규정에 불구하고 일방은 상대방의 추가 평가 등의 요청이나 “정보”的 제공 요청이 상호 이익 원칙에 반하여 일방에게만 유리한 것인 경우 이러한 사유를 소명하고 위 요청을 거부할 수 있다.

### 제 5 조(비밀유지)

- ① “삼성전자”와 “공동평가자”는 상대방의 사전 서면 승인이 없는 한 상대방의 정보를 본 공동평가 이외의 다른 목적이나 용도로 사용할 수 없으며, 본 공동 평가와 관련하여 사용할 경우에도 필요한 평가작업 수행 범위를 초과하여 정보를 임의로 복제, 수정, 저장, 변형 또는 분석하는 등의 행위를 할 수 없다.
- ② “삼성전자”와 “공동평가자”는 본 공동평가를 수행함에 있어 직, 간접적으로 알게 된 상대방의 정보를 상대방의 사전 서면 동의 없이 별첨3. 비밀보호서



약서에 서명 또는 기명날인을 한 관련 임직원 이외의 제3자에게 공개 혹은 제공(제3자에게 비밀유지의무를 부과하면서 공개하는 행위 포함)할 수 없다.

- ③ 본 조의 비밀유지의무는 제3조의 공동평가기간 만료 등의 사유로 본 계약이 종료된 이후에도 1년간(이하 "비밀유지기간"이라 한다) 유효하다.
- ④ "삼성전자"와 "공동평가자"가 별도로 비밀유지계약을 체결한 경우에는 그 비밀유지계약이 본 조에 우선한다.

#### 제 6 조(평가작업의 결산 및 기여분 보상)

- ① 양 당사자는 별첨 1. 평가계획서의 일정에 따라 공동평가기간 동안 최소 1회 이상 평가작업 수행에 따른 설비의 성능개선 내용, 구조변경 등 실적을 정리하고, 이러한 실적에 대한 각자의 기여도 등을 협의, 확정하여 서면화 하기로 하되, 각자의 기여도는 합리적 소명 자료에 의하여 결정한다.
- ② 양 당사자는 본 계약의 평가 설비와 관련하여 공동평가기간 중 고안된 "지식재산권"에 대하여 발명자 우선주의에 따라 독자적 발명은 각자가 권리를 갖되, 공동 소유를 주장하는 당사자가 합리적인 소명자료를 제출하는 경우 공동소유로 한다. 단, 후술하는 본 조 제 4 항의 규정에 따라 각 당사자의 기술 분야에 관하여는 그러하지 아니하다.
- ③ 양 당사자는 상대방을 위하여 해당 설비의 평가작업으로 인하여 획득한 자신의 "지식재산권"의 실시를 본 계약에 따른 공동평가기간 동안 평가목적 범위 내에서 무상 허여하여야 한다. 다만 "지식재산권" 실시 허여에 따른 세부조건에 대하여는 별도의 라이선스 계약을 통하여 확정한다.
- ④ 본 조 제 2 항, 제 3 항의 규정과는 별도로, 각 당사자는 자신의 기술 분야(원익 IPS: 하드웨어 관련 기술, 삼성전자: 공정 관련 기술)에 대한 특허, 실용신안, 디자인 등 지식재산권을 출원할 수 있는 권리를 가지며, 상대방의 기술적 지원 등이 있는 경우에도 전술한 기술 분야에 관한 기술 소유권은 원칙적으로 해당 분야에 대한 당사자가 보유하는 것으로 한다. 또한 본 계약에 따른 평가작업 중에 삼성전자의 영업비밀 관련 정보 내지 자료의



제공 등 삼성전자의 기여로 설비의 구조변경, 성능개선이 발생한 경우에도 하드웨어 관련 기술의 경우에는 공동평가자의 독자적인 권리로 한다.

- ⑤ 본 조 제 4 항에 따른 각 당사자의 기술 분야 외에 제 1 항에 따른 실적 정리 결과, 삼성전자의 기여도가 입증된 기술과 관련하여서는 삼성전자와의 협의절차 없이 또는 삼성전자의 의사에 반하여 제 3 자를 위하여 해당 기술과 동일한 기술을 적용한 설비를 제작, 판매하거나 해당 기술과 관련된 정보를 제 3 자에게 제공하는 경우 삼성전자는 공동평가자의 해당 행위의 중지를 요청하거나 손해배상을 청구할 권리를 가진다.

#### 제 7 조(결과물의 구매)

- ① 삼성전자는 설비의 구조변경, 평가작업의 수행 등 평가작업을 마친 설비가 별첨 1. 평가계획서에 명시된 평가목표를 달성하고 양산성이 있다고 판단할 경우 공동평가자에 대하여 구매를 요청할 수 있으며, 이 경우 공동평가자는 삼성전자의 평가작업에서의 기여도를 고려하여 최혜조건으로 공급하여야 한다.
- ② 제 1 항에 따라 설비가 별첨 1. 평가계획서에 명시된 평가목표를 달성하고 양산성이 있다고 판단되더라도 삼성전자가 해당 설비를 반드시 구매할 의무를 부담하는 것은 아니다.

#### 제 8 조(계약의 해제 또는 해지)

- ① 삼성전자 또는 공동평가자 중 어느 일방에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 상대방은 최고 없이 본 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.
1. 발행한 어음이나 수표가 부도 또는 거래 정지된 경우
  2. 감독관청으로부터 영업정지 또는 영업면허, 영업등록 등의 취소처분을 받은 경우
  3. 파산절차 또는 회생절차가 시작되거나 이러한 신청이 있는 경우
  4. 가압류·가처분 등으로 본 계약의 목적달성이 곤란하다고 판단될 경우



5. 본 공동평가 수행이 정지되거나 기타 사유로 소기의 개발 성과를 기대하기 어려운 경우
  6. 양 당사자 중 어느 일방이 공동평가를 완수할 능력이 없어졌다고 객관적으로 판단되는 경우
  7. 기타 중대한 사유로 인하여 본 공동평가를 계속할 수 없다고 판단되는 경우
- ② 삼성전자 또는 공동평가자 중 어느 일방이 본 계약을 위반한 경우 상대방은 14일의 기간을 두고 그 시정을 최고한 후, 시정되지 않을 경우 본 계약을 서면통지에 의해 해제 또는 해지할 수 있다.
- ③ 본 조에 의하여 본 계약이 해제 또는 해지될 경우, 양 당사자는 해제 또는 해지된 날로부터 20일 이내에 상대방으로부터 제공받은 “자료”를 모두 반환하거나 파기하여야 한다.

#### 제 9 조 (손해배상)

삼성전자와 공동평가자 중 어느 일방이 본 계약에 규정된 의무를 위반하거나, 이행을 게을리하거나 또는 지연시킬 때에는 그 행위를 야기한 당사자는 그러한 불이행에 대해 전적으로 책임을 지며, 그에 따른 일체의 손해를 배상함과 동시에 상대방이 요청하는 모든 적절한 조치를 취해야 한다.

#### 제 10 조(일반 조항)

- ① 본 계약의 내용과 별첨의 내용은 양 당사자의 서면 합의에 의하여 변경할 수 있다. 일방이 비용에 관한 각자 부담의 원칙을 수정할 것을 요청하는 경우 상대방은 성실히 이에 응하여 협의를 진행하여야 한다.
- ② 본 계약과 관련하여 해석상 이의가 있을 때에는 양 당사자의 합의에 의하여 결정하되, 소송을 제기할 경우에는 수원지방법원을 관할법원으로 한다.
- ③ 양 당사자는 본 계약상의 지위 및 본 계약상의 권리의 전부 또는 일부를 상대방의 서면 합의 없이 제3자에게 양도, 이전할 수 없다.



별첨 1 : 공동평가계획서

별첨 2 : 설비 Spec

별첨 3 : 비밀보호서약서

위와 같이 계약이 체결되었음을 증명하기 위하여 “삼성전자와 “공동평가자”는 본 계약서는 2 부를 작성하여 각 기명 날인하고 각 1 부씩 보관한다.

2016년 4월 3일

삼성전자 주식회사

경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)

대표이사 권오현



“공동평가자”

주식회사 원익아이피에스

경기도 평택시 진위면 진위사단로 75

대표이사 변정우



## 별첨 1. 공동평가계획서

### 1.1 평가목표

- V-NAND향 MOLD OX설비 안정성, 양산성 및 공정 평가

VHF KIT을 통한 UPEH 생산성 검증

### 1.2 역할분담

	삼성전자	원익아이피에스
역할	1. 평가용 Wafer 제공과 특성평가 2. 공정 기본 Recipe 작성 3. Process 평가 및 분석 4. Utility Set Up Support	1. H/W Installation 2. H/W Set Up 및 관리 3. Process Base Line 제공 4. Process/H.W 개발

※ 평가를 수행하기 위하여 발생하는 비용과 관련하여

양 당사자는 역할분담에 따라 발생하는 비용을 각자 부담하기로 한다.

### 1.2 평가 일정

ITEM	月	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
설비 개조 및 SET UP		●											
공정 평가			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
H/W 양산성 평가			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
중간 결과 보고				●			●			●			●
JEP 종료/ 실적 정리													●



## 별첨 2. 설비 Spec.

### ■ WONIK IPS MOLD OX Process spec

V4

Item	항목	최종합의안	SPEC.기준(V4조건)
H/W	Setup	Setup	2TM, 3 / 5Chamber
양산성	UPEH	> 6 wfs/hr * 1 Chamber	@ 14 Pair ( SIN/TEOS=355/235 ) 표준UPEH기준(MCC UPEH)
		> 30 wfs/hr * 5 Chamber	
	MTBP	> 4000 wfs * 1 Chamber	@ 14 Pair ( SIN/TEOS=355/235 )
	가동률 (시간 가동률+R/D)	>80%	투자 가동률 85% 기준
			R/D 5% 기준
단막질	HTSIN	WIW, WTW Unif.	< 1.5% All layer (EE 3mm@13pt)
		RI	1.91 ±0.01 2K, 633nm
		STRESS	350±30 Mpa @ As Depo 2K
		ΔSTRESS	180±30 Mpa @ 850C/30M, 2K
		WET E/A	900±50 Å/min @ HPO, 10min
			5±5 Å/min @ HF 200:1 , 2min
	HTTEOS	WIW, WTW Unif.	< 1.5% All layer (EE 3mm)
		RI	1.46±0.01 290Å, 633nm
		STRESS	-350 ± 50 Mpa @ As Depo 2K
		WET E/A	<2 Å/min. @ HPO, 10min
			40±5 Å/min @ HF 200:1 , 2min
STACK	In-Situ Stack	AVG 산포	± 100Å @ 1st Mold 14P
		WL to WL THK 산포	<10Å TEM
		Range	< 420Å ( Unif. < 1.5% ) @ 14000 Å (24P)
		PC	<70ea @ 14P DPC
		LER 3σ	<5nm TEM 기준 (WL7)
		Warp.	±20um @ Last Full Stack
	Process	IN FAB / 수율	선행 양산 설비 동일 수준
	Integration		



## ■ WONIK IPS Hardware 주요 Configuration

신규 시스템을 제작하여 평가용 설비로 제공하지 않고,  
기존 계약 종료 전의 평가 설비 (TOIH32 호기\_ '13년 5월도입)를 구매 전환하지 않은 상태로  
본 건 JEP 평가 설비로 지속 활용하여 평가 진행함.

Section	Item	16L MOLD	Remarks
1. EFEM	SFEM MAKER / MODEL	CYMECHS / SFEM-1440-MAHA MP	
	EFEM LOAD PORT	2 LOAD PORT	
	EFEM LOAD PORT N2 PURGE KIT	NO	
	EFEM IONIZER	NO	
	EFEM ALIGNER	NO	
	EFEM CONTROLLER COOLING FAN	YES (QTY : 8EA)	
	EFEM INNER LAMP	YELLOW LED	
	EFEM LIGHT CURTAIN	PROTECTION BAR	
	EFEM CONTROL MONITOR TYPE	SWING TYPE, TOUCH PANEL(PEN)	
	EFEM SIGNAL TOWER LOCATION	FRONT,LEFT / REAR, LEFT	
	EFEM DOOR VALVE MAKER / MODEL	PRESYS / RDV-300	
	EFEM DOOR VALVE TYPE	L-MOTION	
	FI ROBOT MAKER / MODEL	YASKAWA / M124E	
	FI ROBOT ARM TYPE / MATERIAL	DUAL END EFFECTOR / ALUMINUM	
	FI ROBOT END EFFECTOR TYPE / MATERIAL	EDGE GRIP TYPE / ALUMINA (Al2O3)	
	LP MAPPING CYLINDER O-RING	SILICON O-RING	
	POWER SUPPLY	CUSTOMER(SEC)	
	UPS SUPPLY	CUSTOMER(SEC)	
	SEC Common Spec. Install	Ver. 2.2.0	
	ATM Robot Magentic Seal Addition	158µL	
	ATM Robot Improve Cover Change	일반 Cover	
	SFEM Leveler Nut Flat & Spring Washer Addition	N/A	
1-1. TM	TRANSFER MODULE MAKER / MODEL	KOSTEK / TWINSTAR 3B-2	
	VACUUM ROBOT MAKER / MODEL	ULVAC / COVOT6-X5 (7-AXIS)	
	VACUUM ROBOT ARM TYPE / MATERIAL	4ARM5 LINK TYPE / ALUMINUM	
	VACUUM ROBOT END EFFECTOR TYPE / MATERIAL	SINGLE END EFFECTOR / ALUMINA (Al2O3)	
	LOAD LOCK N2 PURGE KIT	YES	
	LOAD LOCK SLIT V.V MAKER / MODEL	VAT / 0210X-BA24-BYP2	
	LOAD LOCK SLIT V.V TYPE	MONO	
	LOAD LOCK SLIT V.V STOPPER MATERIAL	PEEK	
	LOAD LOCK SLIT MATERIAL	AL6061	
	LOAD LOCK DIFFUSER MAKER / MODEL	엔티그리시스템 / FV-40T	
	LOAD LOCK GAUGE MAKER / MODEL	필립스 / 275807-EU 1/4"	
	TM GAUGE_1000torr MAKER / MODEL	필립스 / 275807-EU 1/4"	
	TM GAUGE_10torr MAKER / MODEL	-	
	TM INTERFACE BOARD	DLO/ALO 일체형 BOARD(KOSTEK)	
2. PH	VAC. ROBOT TEACHING PANDANT	DigitalBit	
	REGULATOR	Normal	
	MANUAL VALVE	Normal	
	TM Leveler Nut Flat & Spring Washer Addirion	N/A	
	PM MODULE	3PH	
	PM ALLOCATION	PMA,PHB,PHC	
	PM MATERIAL	AL6061	
	PM WALL HEATING	Yes (Heat Exchanger 80°C)	
	PM WALL COATING	N/A (AL Bare)	
	PM POWER BOX COOLING FAN	YES (QTY : 2EA)	
	PM 10Torr CHAMBER GAUGE	MKS / BARATRON GAUGE @ 626B11TB8, None Heating	
	SHOWER HEAD	315°C COOLING TYPE 일체형 S.H	
	SHOWER HEAD MATERIAL	AL6061	
	SHOWER HEAD COATING	NO	
3. ALN Heater	SHOWER HEAD TYPE	3 Layer (Top/Blocker/End), 병사형	
	HF GENERATOR MAKER / MODEL	AE / PARAHOUNT 1.5K	
	LF GENERATOR MAKER / MODEL	AE / PDX900-153	
	HF MATCHER MAKER / MODEL	PLASHART / PFDUAL-6D (PF 1) (6W!전개)	
	RPG GENERATOR MAKER / MODEL	IHP / IHP-10KH V01.1	
	RPG REACTOR MAKER / MODEL	IHP / IPR-509L- V08	
	PM SLIT VALVE MAKER / MODEL	V-TEX / IRF-09082-2-01-R4	
	PM 2STAGE VALVE MAKER / MODEL	VAT / 0913B-PE44-AH61 (Side1) VAT / 0913B-PE44-AH61 (Side2)	
	ALN HTR. MAKER / MATERIAL / ZONE	INGK / ALH / 1ZONE, Inch mount	
	ALN HTR UD COATING	NO	
	ALN HTR MAXIMUM TEMPERATURE	550°C @ Set Temp.	
	ALN HTR HEX COOLING	YES	
	ALN HTR TEMP CONTROLLER	EUROTHERM / E2216	
	ALN HTR RF FILTER	YES	



	IGS PANEL MAKER	HAMLET	
	IGS PANEL TYPE	1.125" C-SEAL	
	IGS PANEL SIGNAL	DEVICE NET Type	
	IGS PANEL AIR VALVE	HAMLET	
	IGS REGULATOR TYPE / MAKER / MODEL	NORMAL / TESCOM社	
	MFC TYPE	PI MFC	
	MFC MAKER	BROOKS / MKP社(Toih32)	
	O2 MFC (Kind/Range/Quantity)	BROOKS, GF-125(PI MFC) / 15SLM / 6EA (2EA/1PM)	
	NF3 MFC (Kind/Range/Quantity)	BROOKS, GF-125(PI MFC) / 10SLM / 6EA (2EA/1PM)	
	Ar MFC (Kind/Range/Quantity)	BROOKS, GF-125(PI MFC) / 10SLM / 18EA (6EA/1PM)	
	Ar MFC (Kind/Range/Quantity)	BROOKS, GF-125(PI MFC) / 15LM / 6EA (2EA/1PM)	
	He MFC (Kind/Range/Quantity)	BROOKS, GF-125(PI MFC) / 10SLM / 12EA (4EA/1PM)	
4. Gas System	SiH4 MFC (Kind/Range/Quantity)	BROOKS, GF-125(PI MFC) / 0.5SLM / 6EA (2EA/1PM)	
	NH3 MFC (Kind/Range/Quantity)	BROOKS, GF-125(PI MFC) / 4SLM / 6EA (2EA/1PM)	
	N2 MFC (Kind/Range/Quantity)	BROOKS, GF-125(PI MFC) / 20SLM / 6EA (2EA/1PM)	
	N2O MFC (Kind/Range/Quantity)	BROOKS, GF-125(PI MFC) / 20SLM / 6EA (2EA/1PM)	
	N2O MFC (Kind/Range/Quantity)	-	
	GAS LINE FILTER_Ar	-	
	GAS LINE FILTER_O2	NAS CLEAN社 / N-100TF-25-32A	
	GAS LINE FILTER_FINAL	MOTT社	
	LIQUID LINE FILTER	HSP社 / VPG-A3	
	GAS LINE AIR VALVE MAKER	FUJIKIN	
	GAS LINE HEATING JACKET MATERIAL / MAKER.	PTFE / FINE	
	VAPORIZER MAKER / TYPE	FLVS 5.7g REV.0	
	FORE LINE HEATING JACKET MATERIAL / MAKER.	SILICON MANTLE / FINE	
	FORE LINE CENTERING TYPE	NORMAL TYPE	
5. Vacuum	FORELINE GAUGE_20Torr	MKS / BARATRON GAUGE @ 626B21TBE, None Heating	
	O-RING TYPE	Chemraz / Kalrez / Viton(BackBone&Fore Line)	
	THROTTLE VALVE	VAT / 61238-XAAG-AZ11 - 2side VAT / 61238-XAAG-AZK1 - 1side	
	MAIN POWER SUPPLY	CUSTOMER(SEC)	
	MAIN POWER CAPACITY	208V, 3상, 350A (3PM) / 208V, 3상, 250A (2PM)	
	FREQUENCY	50/60 Hz	
	UPS POWER SUPPLY	CUSTOMER(SEC)	
	UPS POWER CAPACITY	208V, 1상, 100A (3PM) / 208V, 1상, 50A (2PM)	
6. Utility	CABLE LENGTH	Signal : 15 Meters, Power : 설측/제단	
	RPG RACK POWER SUPPLY (VDP 전원)	CUSTOMER(SEC)	
	RPG RACK POWER CAPACITY	208V, 3상, 300A (3PM) / 208V, 3상, 200A (2PM)	
	SYSTEM(GAS BOX) FACILITIES	BOTTOM CONNECTION	
	CABLE DUCT SUPPLY	CUSTOMER	
	CABLE TRAY SUPPLY	CUSTOMER	
	DRY PUMP & POWER SUPPLY	CUSTOMER	
	Dry Pump Maker	CUSTOMER	
	Dry Pump Model for PM	CUSTOMER	
	Dry Pump Model for TM	CUSTOMER	
	Dry Pump Model for LL	CUSTOMER	
7. Sub-System	SCRUBBER & POWER SUPPLY	CUSTOMER	
	Scrubber Maker	CUSTOMER	
	Scrubber Model	CUSTOMER	
	HEX & POWER SUPPLY	SUPPLY	
	Heat Exchanger Maker	TAKIST	
	Heat Exchanger Model	LC-X40V	
	SYSTEM CONFIGURATION	Industrial P/C, Quad Core CPU / RAM 1G*4EA	
8. Controller	SYSTEM OS	WINDOWS 7_KOR VER.	
	SYSTEM STORAGE	SSD 840 512GB	
	CONTROLLER TYPE	PC/DEVICE NET	
	CD-RW INSTALLATION	Not Required	
9. Safety	이중 INTLK 강화 (MPB 등)_15' common spec.	None	
	Safety PLC_15' common spec.	None	
	TEOS 역류 safety강화	None	
	Chamber Lid 협착 개선인 safety강화	None	
	HEX 순간경전 대응 safety강화	None	
10. ML.MLT MULTIPACKAGE	AR.HOT KIT	None	
	AR.SHORT MERGE	None	
	O2 HOT KIT	None	
	O2 MERGE	None	
	HEATING JACKET TEMP 200	None	
	INDIVIDUAL DIVERT LINE	None	
11. 추가 요청사항	DVR CAMERA	None	
	T-PORT 개선형 적용	None	
	DOOR 개선형 적용	None	
	VHF KIT	Apply	

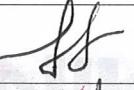
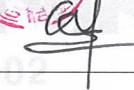
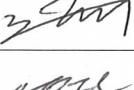
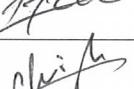


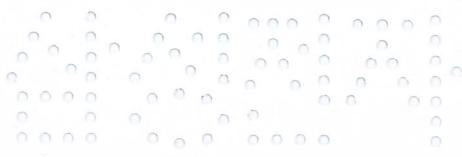
별첨 3.

## 비밀보호서약서

아래 참여자는 본 계약 제5조(비밀유지)를 세심히 읽어 보았으며, 상대방의 정보를 제3자에게 공개 혹은 제공하지 아니하며, 상대방의 정보보호 정책과 관련된 내부규칙을 엄격히 준수할 것을 서약합니다.

< 삼성전자 주식회사 >

No	부서명 (Department)	부서장 (Manager)	참여자 (Participant)	서명/印 (Signature)	사원번호 (Employee NO)	비고 (Remark)
1	메모리 기술팀 H3 CVD	임민규	임민규		960549142	
2	메모리 기술팀 H3 CVD	임민규	박연수		9838305	
3	메모리 기술팀 H3 CVD	임민규	이재혁		0735-0960	
4	메모리 기술팀 H3 CVD	임민규	조규태		96017980	
5	메모리 기술팀 H3 CVD	임민규	나원철		06317937	
6	메모리 기술팀 H3 CVD	임민규	최정희		04128965	
7	메모리 기술팀 혁신 R&D	노상호	김재석		96037546	
8	메모리 기술팀 혁신 R&D	노상호	김은숙		89915719	
9	설비인증사업그룹	이재봉	이준성		11276783	
10	설비인증사업그룹	이재봉	최종철		15024814	
11						
12						



< 주식회사 원익아이피에스 >

No	부서명 (Department)	부서장 (Manager)	참여자 (Participant)	서명 (Signature)	사원번호 (Employee NO)	비고 (Remark)
1	반도체 1 사업본부	원제형	원제형		2150207	
2	반도체 1 사업본부	원제형	신흥재		2150206	
3	반도체 1 사업본부	원제형	박진형		2160101	
4	반도체 1 사업본부	원제형	서상호		2131002	
5	반도체 1 사업본부	원제형	조일상		2040302	
6	반도체 1 사업본부	원제형	김민		2150901	
7	반도체 1 사업본부	원제형	권영수		2090302	
8	반도체 1 사업본부	원제형	나경필		2081201	
9	반도체 1 사업본부	원제형	송병호		2120705	
10	반도체 1 사업본부	원제형	정종욱		2100803	
11	반도체 1 사업본부	원제형	채일호		2040406	



한국어

